

実装フェスタ関西2023のご案内

日時：2023年 7/6 (木) ~ 7/7 (金)

場所：パナソニックリゾート大阪

大阪府吹田市青葉丘南10-1 TEL 06-6877-0111

HP：<https://jiep.or.jp/event/workshop/jfk2023/index.php>



関西支部創立20周年記念バージョン

昨年に引き続き活発な議論と人材交流の場としてリアル開催を実施

関西支部創立20周年の祝賀イベントと新たな企画を計画



学生参加の優遇

人材育成と若手技術者交流の観点から

多くの学生さんの参加を期待

学生参加費を従来以上に優遇 (0円~)

スポンサーセッション新設

スポンサー企業の保有する技術や会社を紹介をする

セッションを新設 セッション参加学生には特典

『2日目の昼食クーポン進呈』を準備 (上限あり)

特別講演 7/6 (木) 13:00~14:00

※特別講演のみオンライン形式

「ホリエモンが宇宙開発にみる夢と未来」

堀江 貴文 氏 (SNS media & consulting)

招待講演 7/6 (木) 14:15~16:30

「チップレット時代における半導体パッケージ革命」

折井 靖光 氏 (Rapidus)

「今後の医療技術開発はどうあるべきか」

國友 哲之輔 氏 (公正研究推進協会)

「製造業から食サービス事業への挑戦」

大野 敦子 氏 (パナソニック)

「感動を生み出すためのハプティクス技術開発」

中川 佑輔 氏 (ソニー)

「量子コンピュータ最新動向と未来技術」

藤井 啓祐 氏 (大阪大学)

「ヘテロジニアスインテグレーションに対応したパッケージ基板技術の動向」

片桐 規貴 氏 (新光電気工業)

特別講演 7/6 (木) 16:45~17:30

「CROSS POINT ~分野間コミュニケーション~」

パネリスト 平本 俊郎 氏 (応用物理学会 会長, 東京大学生産技術研究所 教授)

那須 秀行 氏 (JIEP 常任理事, 古河電気工業)

折井 靖光 氏 (JIEP 前副会長, Rapidus 専務執行役員)

齊藤 丈靖 氏 (JIEP 前関西支部長, 大阪公立大学 教授)

ナイトセッション 7/6 (木) 19:45~20:45

招待講演のテーマにて、各講師とグループディスカッション

基調講演 7/7 (金) 11:00~15:15

「半導体産業の川上“結晶”の重要性」

森 勇介 氏 (大阪大学)

「デジタル&チップ列島改造」

若林 秀樹 氏 (東京理科大学大学院)

「半導体・デジタル産業戦略について」

金指 壽 氏 (経済産業省 商務情報政策局)

ポスターセッション 48件を予定

第1部 7/7 (金) 9:15~10:45

第2部 7/7 (金) 15:30~17:00

- ・ I-Beamを用いた高周波対樹脂に対する無電解銅めっき膜の密着性向上
- ・ SiC素子の小型化を実現する0-タ銅を用いた熱リユージョン
- ・ マテリアル・インフォマティクスによるサステナブル複合材料の高信頼設計技術
- ・ Pb,Agフリー高耐熱はんだの接合信頼性評価
- ・ 超極薄(薄膜)チップ転写技術の開発
- ・ 無加圧シタターハートの接合強度に及ぼす粒子径と表面処理剤の影響
- ・ 低温熱源利用のためのMEMS小型発電システム
- ・ 金属析出現象を利用したガラス内金属配線技術
- ・ AgSn TLPシートの開発
- ・ 資源循環ナノ粒子回収に適用可能なマカ多孔体の開発
- ・ 有機絶縁材料を用いた微細銅配線の絶縁信頼性
- ・ ストレッチャブルデバイス用伸縮材料の開発
- ・ 貼合・積層技術と貼合・積層技術が活かされている業界
- ・ ガラス・ポリマ-基板上Cu層のPdフリー化学的形成技術
- ・ ガラスヘオールウェットで処理可能なCuめっきプロセスの工業化
- ・ カードハウス型BNファイバーによる超高放熱基板の開発
- ・ 中真空PVDによる導体層の形成技術
- ・ ウェアラブルな小型深部体温計測モジュールの開発
- ・ 球状負の熱膨張ファイバーによるLow-CTE化技術
- ・ 高周波対応 低誘電特性有するカルシウムフェリートの開発

有本 太郎 氏	ウシオ電機株式会社
井手 拓哉 氏	株式会社0-タ・サル・リユージョン
岩崎 富生 氏	日立製作所
上山 棕平 氏	三菱電機株式会社
岡田 達弥 氏	東レエンジニアリング株式会社
越智 豊 氏	
金子 美泉 氏	日本大学
川村 拓史 氏	長岡技術科学大学
岸本 貴臣 氏	田中貴金属工業株式会社
小澤 隆弘 氏	大阪大学
荘司 優 氏	東レ株式会社
椿 幸樹 氏	大阪有機化学工業株式会社
中村 衣里 氏	ケムテック株式会社
橋本 悠衣 氏	豊橋技術科学大学
速水 雅仁 氏	パナソニック環境エンジニアリング
日高 克彦 氏	三菱ケミカル株式会社
深田 和宏 氏	芝浦機械株式会社
福井 翔也 氏	公立諏訪東京理科大学
松永 知恵 氏	三菱ケミカル株式会社
三ノ上 溪子 氏	大阪ケミカル株式会社

JFK2023 スポンサー

ウシオ電機(株), 奥野製薬工業(株), オムロン(株), サンユレック(株),
積水化学工業(株), ソニー(株), (株)太洋工作所, 東レ(株),
東レエンジニアリング(株), (株)日本スペリア社, 日本電子(株), ボンドテック(株)